

Техническое описание продукта

Клейкие пастообразные флюсы (флюс-гели)

Описание продукта

- Используется при доводке и доработке печатных плат
- Применяются для установки шариков припоя при монтаже компонентов BGA (реболлинг)
- Незаменим при пайке компонентов Flip Chip
- Обладает прекрасной смачиваемостью и широким окном процесса пайки
- Совместим с любыми поверхностями печатных плат

Типы флюс-гелей

Название	Тип	Класс
SynTECH-TPF	Б/О	REL0
SynTECH-LF-TPF	Б/О (Lead Free)	REL0
NC-559-TPF	Б/О	REL0
LF-4300-TPF	Б/О и В/О	REL0
4300-TPF	Б/О и В/О	REL0
NC-559-ASM-TPF	Б/О	REL0
WS-488-TPF	В/О	ROL0
NWS-4100-TPF	В/О	REM0
NWS-4200-TPF	В/О	REM0
NWS-4200-4-TPF	В/О	REH0
NWS-4200-6-TPF	В/О	REH1
NWS-4200-LF-TPF	В/О (Lead Free)	REH1
RMA-223-TPF	RMA	ROL0
RMA-223-LF-TPF	RMA (Lead Free)	ROM1
RA-223	RA	ROH1

>8 часов при относительной влажности 20-50% и температуре воздуха 22-28°C
~4 часа при относительной влажности 50-70% и температуре воздуха 22-28°C

Очистка

Предпочтительно использование автоматизированных очистительных систем как при очищении печатных плат, так и при очищении трафаретов. При осуществлении очистки вручную рекомендуется использовать изопропиловый спирт (IPA).

Хранение

Хранение продукта при температуре 42-47F продлит срок годности флюса минимум на год. Шприцы и картриджи следует хранить в вертикальном положении распылителем вниз. За 6-8 часов до использования флюс должен прогреться до комнатной температуры. Никогда не замораживайте клейкие пастообразные флюсы.

Доступная упаковка

Стандартные виды упаковки:
Банки на 75 и 150 гр.
Картриджи на 50 гр.
Шприцы на 10 и 30 куб. см

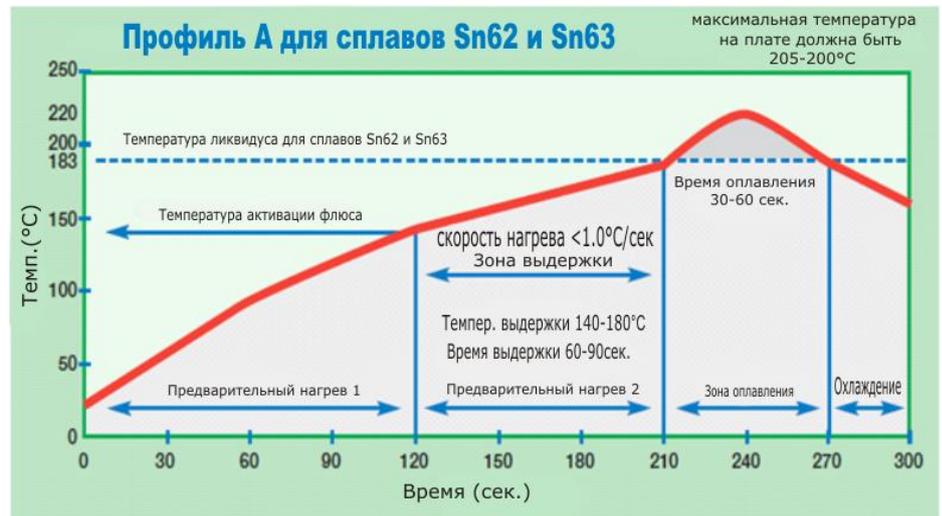
(продолжение)

Клейкие пастообразные флюсы (флюс-гели)

Рекомендуемые профили:

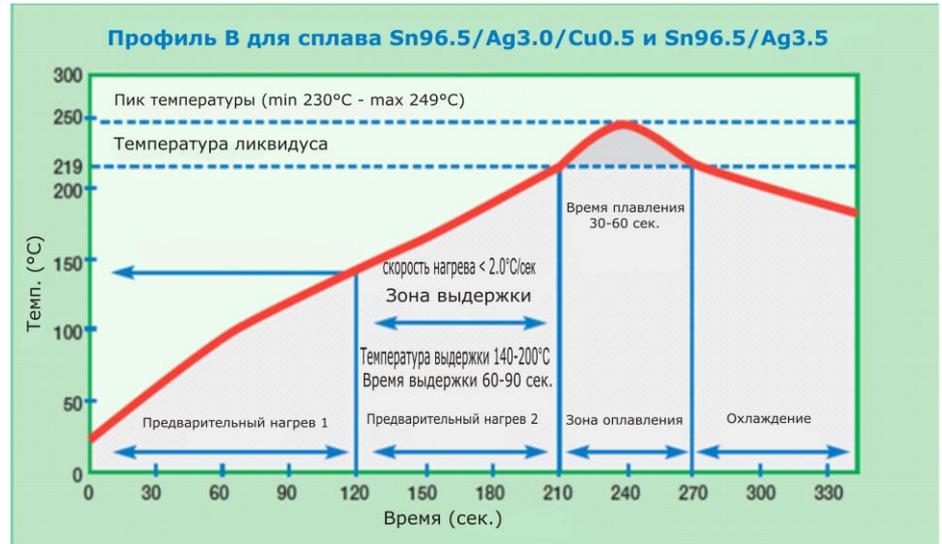
Профиль-А

Этот профиль разработан для начала процесса оптимизации при использовании клейких пастообразных флюсов (флюс-гелей). Скорость охлаждения (-) 2 – 4 °C/сек является идеальной для формирования тонкой структуры гранул без риска повреждения термически чувствительных компонентов. Рекомендуется при пайке сплавов Sn63 или Sn62.



Профиль-В

Этот профиль разработан для начала процесса оптимизации при использовании клейких пастообразных флюсов (флюс-гелей). Скорость охлаждения (-) 2 – 4 °C/сек является идеальной для формирования тонкой структуры гранул без риска повреждения термически чувствительных компонентов. Рекомендуется при пайке сплавов Sn96.5/Ag3.0/Cu.5 и Sn96.5/Ag3.5.



Информация, содержащаяся в настоящем документе, основана на технических данных, которые мы считаем надежными и предназначена для использования лицами, имеющими технические навыки.

Пользователи наших продуктов должны пройти свои собственные тесты, чтобы определить пригодность каждого изделия для их конкретного процесса. AMTECH не может нести ответственность за полученные результаты или убытки, возникшие в результате применения представленных данных.

AMTECH
Передовые SMT паяльные материалы